關於碳化硅外延層厚度確定的數學建模與算法分析報告

2025年9月6日

摘要

本報告針對紅外干涉法測量碳化硅(SiC)外延層厚度的問題,建立了一套從理論建模到數據處理的完整分析流程。首先,基於薄膜干涉原理,我們推導了描述光程差(OPD)與外延層厚度 d、折射率 n_1 及入射角 θ 之間關匠的二**光束干涉模型**。其次,針對模型中 n_1 未知且存在色散的問題,我們設計了一種基於**快速傅立葉變**匠(**FFT**)的穩健算法,該算法能直接從光譜數據中提取 OPD。在處理 SiC 樣品數據(附件 1、2)時,我們識匠匠排除了材料本徵吸收帶(Reststrahlen band)的干擾,匠通過對比雙角度測量結果,論證了在高折射率材料中應匠用引人先驗知識的策略。最終確定 SiC 外延層厚度匠 $d=7.73\pm0.01~\mu$ m。最後,通過分析硅樣品(附件 3、4)的 OPD 譜諧波成分,我們確證了多光束干涉的存在性,匠闡述了其對測量精度的影響及相應的建模策略(Airy 模型)。本報告所提方法具有高精度和匠魯棒性,匠半導體薄膜的無損檢測提供了可靠的解匠方案。

1 二光束干涉模型的建立

1.1 物理情景分析

紅外光入射到外延層表面時,發生反射和折射。如圖 1 所示, '反射光 1'由空氣-外延層界面直接反射形成; '反射光 2'由入射光折射進入外延層,經外延層-襯底界面反射後,再次折射回空氣中形成。這兩東光因傳播路徑不同而臣生光程差,從而發生干涉。

1.2 數學推導

1. 基本參數定義:

- d: 外延層厚度。
- θ_i : 空氣中的入射角。
- θ_r : 外延層中的折射角。
- n_0 : 空氣折射率, 設 $n_0 = 1$.
- *n*₁: 外延層折射率。
- λ : 真空中的波長; $\tilde{\nu} = 1/\lambda$: 波数。
- 2. 斯涅爾定律 (Snell's Law): 光 正在空氣-外延層界面的折射遵循斯涅爾定律:

$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r \implies \sin \theta_r = \frac{\sin \theta_i}{n_1}$$

3. 光程差 (Optical Path Difference, OPD) 計算: '反射光 2'相較於 '反射光 1'增加的光程主要發生在外延層臣部。其幾何光程差 OPD_{geom} 臣:

$$OPD_{geom} = 2n_1 d \cos \theta_r$$

利用 $\cos \theta_r = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_r} = \sqrt{1 - (\sin \theta_i / n_1)^2}$, 可得:

$$OPD_{geom} = 2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_i}$$

- **4.** 相位突變分析: 光的反射可能伴隨相位突變。當光從光疏介質射向光密介質時,反射光有 π 相位突變(相當於 $\lambda/2$ 光程)。
 - 界面 1 (空氣-外延層): $n_1 > n_0$ (SiC 折射率約 2.6 > 空氣 1), 發生 π 相位突變。
 - **界面 2 (外延層-襯底)**: 襯底通常 \mathbb{F} 重摻雜 SiC, 其載流子效應會使其在紅外波段的折射率 n_2 低於輕摻雜的外延層 n_1 。因此假設 $n_1 > n_2$,反射時無相位突變。

兩東光之間存在一次 \mathbb{P} 的 π 相位突變。值得注意的是,即使 $n_1 \leq n_2$ 的假設成立(即界面 2 也發生 π 相位突變),總的 \mathbb{P} 相位差將變 \mathbb{P} 0 或 2π 。這僅會將相長與相消干涉的條件互 \mathbb{P} 。然而,由於我們後續 \mathbb{P} 用的傅立葉變 \mathbb{P} 算法是對信號的 \mathbf{k} \mathbb{P} 頻率進行分析,而非依賴於極值的 \mathbb{P} 對位置,因此**該算法的結果對於相位突變的假設是穩健的**。

5. 干涉條件方程:

• 相消干涉 (反射率極小值): 總光程差 Γ 波長的整數倍 $m\lambda$ 。

$$OPD_{geom} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \implies OPD_{geom} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

• 相長干涉 (反射率極大值): 總光程差 \mathbb{P} 半波長的奇數倍 $(m+1/2)\lambda$ 。

$$OPD_{geom} + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \implies OPD_{geom} = m\lambda$$

1.3 最終模型

將 OPDgeom 代入相長干涉條件 (對應反射光譜的峰值),得到用於厚度計算的基本模型:

$$2d\sqrt{n_1(\tilde{\nu})^2 - \sin^2\theta_i} = \frac{m}{\tilde{\nu}_{\text{max}}}$$

其中 m \mathbb{E} 干涉級數(正整數), $n_1(\tilde{\nu})$ 表示折射率隨波数變化的色散關 \mathbb{E} 。此模型構成了後續算法設計的基礎。

2 SiC 外延層厚度算法設計、計算與可靠性分析

2.1 算法設計:傅立葉變 []法

直接求解模型 (1.3) 面臨兩大挑戰: (1) 干涉級數 m 未知; (2) 折射率 $n_1(\tilde{\nu})$ 是未知的 \mathbb{E} 數。我們 \mathbb{E} 思想。我們 \mathbb{E} 用**博立葉變 E** 法規避這些問題。干涉信號 $R(\tilde{\nu})$ 在波数域的振 \mathbb{E} 可以視 \mathbb{E} 一個調頻信號,其「瞬時頻率」與 OPD 相關。對 $R(\tilde{\nu})$ 進行傅立葉變 \mathbb{E} ,可以將其變 \mathbb{E} 到共 \mathbb{E} 其一光程差域。在 OPD 譜上,干涉信號將在 $\tilde{\nu}_{\text{center}}$ 對應的平均光程差 OPD avg 處形成一個清晰的峰值。

算法步驟:

- 1. **數據加載與預處理**: 讀取光譜數據 $(\tilde{\nu}, R(\tilde{\nu}))$ 。
- 2. 數據篩選: 識匠匠排除物理模型不適用的區域(如材料本徵吸收帶)。
- 3. **插值:** 將非均匠匠樣的波数數據通過匠性插值轉匠匠均匠網格,以滿足 FFT 算法要求。
- 4. 基**E校正**: **E**用 **Savitzky-Golay 滤波器**擬合光譜的低頻背景趨勢。該背景主要由儀器響應函數和材料的宏觀光學特性貢獻,其移除是**E**了分離出高頻的干涉信息。
- 6. 峰值提取:在 OPD 功率譜上定位最匠峰的位置,即匠平均光程差 OPDavg。

2.2 數據分析與結果

- 1. SiC 樣品 (附件 1、2) 初步分析與模型精煉:
 - 現象識E: SiC 光譜在 750-1000 cm ¹ 範圍E存在E 烈的 Reststrahlen 吸收帶。此區域的光學響應由晶格振動主導,不符合透明薄膜干涉模型。
 - 策略調整: E保證模型有效性, 我們將分析範圍限制在 1200 cm 1 至 4000 cm 1 的透明區。

2. 雙角度測量分析:

- **數據獲取**: 對附件 1 ($\theta_i = 10^\circ$) 和附件 2 ($\theta_i = 15^\circ$) 的篩選後數據執行 FFT 算法,得到光程差:
 - $\text{ OPD}_{10^{\circ}} = 39.7371 \,\mu\text{m}$
 - $\text{ OPD}_{15^{\circ}} = 39.7371 \,\mu\text{m}$
- **方法局限性論證**: 兩個角度下的 OPD 值在數值精度[正完全相同。這是因[I] SiC 的折射率 $n_1 \approx 2.6$ 遠大於 $\sin(15^\circ) \approx 0.26$, 導致 $\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i}$ 項對 θ_i 的變化極不敏感。因此,試圖聯立求解 d 和 n_1 的方法在此失效。

3. 引入先驗知識求解:

- 厚度計算:

$$d = \frac{\text{OPD}}{2\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_i}}$$

- 使用 $\theta_i = 10^{\circ}$ 數據: $d = 39.7371/(2\sqrt{2.58^2 \sin^2(10^{\circ})}) = 7.719 \,\mu\text{m}$.
- 使用 $\theta_i = 15^{\circ}$ 數據: $d = 39.7371/(2\sqrt{2.58^2 \sin^2(15^{\circ})}) = 7.740 \,\mu\text{m}$.

3 多光束干涉分析 4

2.3 可靠性分析與結論

兩個角度的計算結果高度一致(相對偏差僅 0.27%),證明了我們的模型、算法和引入的先驗 知識是自治且可靠的。

最終結論: 碳化硅外延層的厚度 \mathbf{E} $d=7.73\pm0.01~\mu\mathrm{m}$ 。此處的不確定度 $\pm0.01~\mu\mathrm{m}$ 是基於兩個不同入射角計算結果 $(7.719~\mu\mathrm{m}$ 和 $7.740~\mu\mathrm{m}$)之間半差的保守估計,它反映了測量數據和所用折射率常數的綜合影響。

3 多光束干涉分析

- 3.1 理論推導: E 生條件與精度影響
- - **高反射率**: 界面反射 \mathbb{P} 數 r_{01}, r_{12} 較大, 使得多次反射後的光 \mathbb{P} 不可忽略。
 - **低吸收損耗**: 薄膜介質的吸收**E**數 *k* 很小, 光能在層**E**傳播損耗低。
- 2. 精度影響: 多光束干涉導致干涉條紋的形狀從二光束干涉的余弦形變 [] 更尖 [] 的 **艾里函數** (Airy function) 形狀。在頻譜上表現 [] 除了基頻峰外,還會出現**高次諧波峰**(位於基頻峰的 2 倍、 3 倍… 處)。若仍 [] 用二光束模型分析,高次諧波的存在會干擾基頻峰的精確定位,從而**降低厚度** 計算的精度。
- 3.2 數據分析: 硅樣品 (附件 3、4)
- **1. 實驗證據:** 對附件 3 (硅樣品) 的光譜數據執行 FFT 分析,得到其 OPD 譜。在 OPD 譜上觀測到兩個顯著峰值:
 - 基頻峰: OPD₁ = 24.65 μm
 - 二次諧波峰: $OPD_2 = 51.38 \, \mu m$

諧波峰的位置與基頻峰的比值 \mathbb{E} OPD₂/OPD₁ ≈ 2.08 ,這非常接近理論值 2。

2. 結論: 硅樣品 OPD 譜中清晰的二次諧波峰是**多光束干涉存在的確鑿證據**。這與硅材料的高折射率(約 3.4)導致的高界面反射率相符。

3.3 SiC 樣品的多光東干涉評估與消除

- 評估: 對 SiC 樣品 (附件 1、2) 精煉後的 OPD 譜進行分析,未發現任何顯著高於噪聲水平的諧波峰。
- 結論: SiC 樣品的多光束干涉效應非常微弱,可以忽略不計。
- 影響消除: FFT 算法本身具有濾波特性。通過提取基頻峰位置來計算厚度,已經天然地濾除了高次諧波的影響。因此,問題二中的計算結果 $d=7.73\,\mu\mathrm{m}$ 已是消除多光束干涉影響後的精確值。

3 多光束干涉分析 5

總結

本報告通過建立嚴謹的物理模型,設計IP實施了穩健的數據分析算法,成功解IP了 SiC 外延層 厚度的確定問題。通過對真實數據的深入分析,我們不僅精確計算了目標參數,還探討了模型的適 用邊界和局限性,展示了在IP雜情IP下結合先驗知識解IP實際問題的科學方法。